

枚葉式スパッタ装置 SP-12000M



基材(4インチまたは3インチウエハ)25枚用のカセットを1個収納できるロード室(アンロード室を兼ねる)を有する、枚葉式装置です。切り換えによりRFモードかDCモードを使用することが出来る生産用の装置です。

枚葉式スパッタ装置 SP-12000M仕様

- 到達圧力 × 10⁻⁵Pa台※常温・無負荷・脱ガス時
- 排気速度 × 10⁻⁴Pa台迄15分以内※常温・無負荷・脱ガス時
- 成膜室径 400mmW × 400mmD × 250mmH SUS304 電解研磨
- ロード室径 400mmW × 400mmD × 250mmH SUS304 電解研磨
- アンロード室径 400mmW × 400mmD × 250mmH SUS304 電解研磨
- スパッタ用電源 RF電源 13.56MHz 2KW 自動マッチング 1台
DC電源 700V 7KW 1台
- 基板形状 3インチもしくは4インチ 1枚
- 膜厚分布 3インチにおいて±10%以内
- ターゲット寸法 8インチ(金属・絶縁物)
- ターゲット個数 1
- 基板回転 無し
- 基板加熱 常温～250℃迄昇温可能
- 真空排気系(成膜室)油回転ポンプ:540L/min
クライオポンプ:1500L/sec
- 真空排気系(L,UL室)油回転ポンプ:540L/min
クライオポンプ:800L/sec
- 操作方法 自動
- ガス系統 マスフローコントローラ 1系統
- ユーティリティ 電気: AC200V三相35KVA
冷却水: 15L/min以上0.1MPa以上0.15MPa以下25℃以下循環
計装エア: 0.5MPa以上
設置寸法: 3000mmW × 2000mmD × 1800mmH